

(31) 焼結鉍中の Hematite 結晶粒度と RDI との関係

(焼結鉍の品質に関する研究第 2 報)

新日本製鉄(株) 生産技術研究所 ○沢村靖昌, 佐藤勝彦, 鈴木 悟
工博 斧 勝也, 宮崎敏樹

1. 緒 言

焼結鉍の還元粉化は焼結過程で生成する 2 次 Hematite⁽¹⁾ が原因で起ることは周知であるが, 還元粉化の指数値 RDI と 2 次 Hematite の量又は形態との対応がとれていないのが現状である。本報では Hematite の粒子径による分類を映像解析装置 (QTM-720) によって行い, RDI との関係を調査検討した。

2. 試料及び測定方法

試料は G 焼結鉍を用いシンターケーキの深さ方向に 8 又は 4 分割したものをを使用した。組織分析は RDI の測定と同一粒度の試料で行った。映像解析装置での粒子径の分類は定方向最大径で分類する方法で行い, 試料の走査面積は各々 340 mm² である。

3. 実験結果及び考察

焼結鉍組織中の Hematite を詳細に観察するとその粒度構成に特徴が見受けられる。即ち未溶解で残存する 1 次 Hematite は 500 μm 以上の粗粒であり, 一方焼結過程で生成する 2 次 Hematite は最大粒子径で 300 μm 前後で粒径に差があること。又 RDI が高いシンターケーキ下層部では 2 次 Hematite 結晶が粗大化していることが判明した。図 1 は全 Hematite 量と RDI の関係を示したもので 1 次 Hematite が分離されていないため両者間の対応がとれていない。図 2 は 100~300 μm の Hematite 粒子と RDI の関係を示したもので組織観察時に推定された傾向が明瞭な相関関係で認められる。図 3 に示すように形態的には同じ 2 次 Hematite と考えられる 100 μm 以下の Hematite については, RDI に対して一定の関係を示さない。このように低温還元粉化の原因となる 2 次 Hematite は粒子径の大きい Hematite が RDI に対する寄与の大きいことを示している。

この原因が粒子径によって 2 次 Hematite の性質 (例えば微量成分の量⁽²⁾, 格子欠陥の程度など) が異なるのか, 又は 2 次 Hematite の性質は変わらないが粒子径の大きいものが還元時の結晶変換に伴う応力発生が大きいのか明らかでない。

4. ま と め

RDI を悪化させる要因としてこれまで 2 次 Hematite の量が考えられていたが, 今回の調査で 2 次 Hematite の結晶粒度が強い影響を持っていることが判明した。

これに関する具体的な RDI 改善策は基本的には 2 次 Hematite の結晶成長を抑えることであり, このためには融体生成時の温度及び雰囲気制御に関する研究が必要である。

- 参考文献 1) 鉄と鋼 56 (1970) S 18
2) 鉄と鋼 59 (1973) P 1209

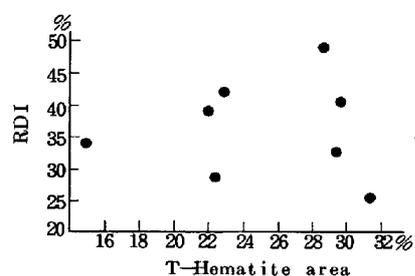


Fig.1. Relation between T-hematite and RDI.

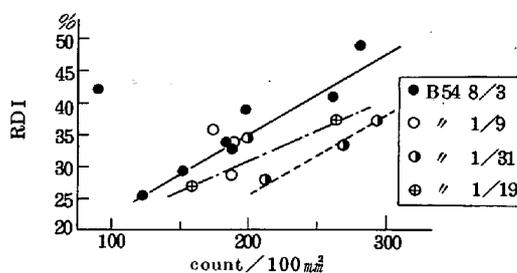


Fig.2. Relation between hematite (grain size-100~300 μm-count) and RDI.

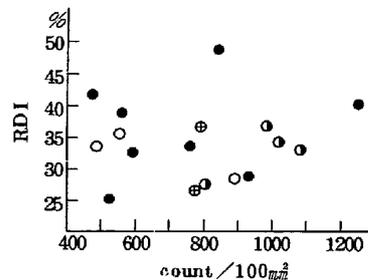


Fig.3. Relation between hematite (grain size-100~300 μm-count) and RDI.